



特色

- ▶ 采用粗铝焊线，以实现低导电电阻与高电流密度
- ▶ 从晶圆测试到成品测试与包装的一站式服务
- ▶ 无铅电镀

正在开发

- ▶ 晶粒贴装采用保护环境的无铅焊膏
- ▶ 无卤素模塑化合物

工艺亮点

- ▶ 互连：粗铝线焊接技术
- ▶ 电镀：100% 雾锡
- ▶ 打标：激光打标

DPAK (TO-252)

DPAK 符合 JEDEC 的中功率电源分立器件标准。

应用

DPAK 适用于中功率应用（参考值为 80W*/60A），且专为低导电电阻和高速切换式 MOSFET 量身定制。特别适用于：

- ▶ 电机驱动器
- ▶ 电源电路
- ▶ DC-DC 转换器
- ▶ 消费类产品
- ▶ 汽车应用产品

*壳温 = 25°C，结温 = 最高 150°C

可靠性认证

Amkor 封装采用成熟可靠的半导体材料。全部可靠性测试包括：

- ▶ JEDEC 标准预处理，高温存储除外
- ▶ 85°C/85% 相对湿度，168 个小时，IR 回流焊 260°C 3X
- ▶ H³TRB：85°C/85% 相对湿度，1000 个小时
- ▶ uHAST：130°C/85% 相对湿度，96 小时
- ▶ 温度循环 -55°C/+150°C，1000 次循环
- ▶ 高温储存：150°C，1000 个小时

测试服务

Amkor 为全部电源分立器件提供完全一站式的服务，我们有能力测试各种类型的电源器件，包括 MOSFET、智能电源器件，等等。

- ▶ 分立电源测试能力：
 - ▷ 直流
 - ▷ 电容 *1
 - ▷ R_g *1
 - ▷ 雪崩耐量测试
 - ▷ 热阻
- ▶ 程序转换
- ▶ 电气故障分析
- ▶ 集成测试、打标、外观检查和卷带式包装服务

*1 仅抽样试验

